

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知已于2024年1月22日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为维护公司价值和股东权益，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。如公司有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励，公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议程序及信息披露义务。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购的价格不超过人民币75元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份

方案之日起不超过 3 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日